

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振，促进资本市场稳定和经济高质量发展，公司发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度“提质增效重回报”行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

### 一、聚焦主营业务，稳步提高核心竞争力

报告期内，公司紧密围绕战略方向，精准捕捉行业升级和国产替代机遇，推进 PCB 设备升级，加快高端阻焊设备扩产，不断丰富泛半导体产品矩阵，推进直写光刻技术应用不断深化。同时，加速推进品牌全球化发展策略，加快布局东南亚市场，以优良的品质和服务积极拓展海外市场，进一步提升产品全球市占率以及品牌影响力。

报告期内公司实现营业收入 44,943.43 万元，同比增加 41.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,069.42 万元，同比增加 38.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,852.98 万元，同比增加 45.84%。

### 1、PCB 产业升级&出口双轮驱动，公司增长动力充足

在 PCB 领域，AI 快速发展带来大算力时代，驱动了对大尺寸、高层数、高频高速、高散热的 PCB 产品的需求，公司紧握行业升级及

国产替代趋势，推动多层板、HDI 板、柔性板以及 IC 载板等中高端 PCB 产品市场份额占比不断提升，同步加大高端阻焊市场的 NEX 系列设备的扩产，凭借设备优异的曝光精度及良率、高效的生产效率、不断下降的设备成本、产品质量的稳定性及本地化服务优势，不断提升国产化替代速度。

国际化战略部署方面，公司在报告期内加大了对东南亚地区的市场布局，以泰国、越南地区为主，积极融入全球化的竞争格局，力争成为微纳直写光刻领域的国际领先企业。目前泰国子公司已完成设立登记，今年公司将积极建设海外销售及运维团队，发挥自身品牌、技术开发和市场营销的优势，增强海外客户的服务能力。当前公司海外拓展速度较快，出口订单表现良好，海外市场的增长将持续推动收入上升。

## **2、泛半导体领域持续开拓新兴市场，直写光刻大有可为**

在泛半导体领域，细分多赛道增速稳定，共同推动光刻设备规模增长。公司直写光刻设备可应用在 IC、MEMS、生物芯片、分立功率器件、IC 掩膜版制造、先进封装、显示光刻等环节，直写光刻技术应用拓展不断深化，共同推动光刻设备规模的持续增长。

IC 载板方面，公司已储备 3-4  $\mu\text{m}$  解析能力的 IC Substrate，技术指标比肩国际龙头企业，目前解析度达 4  $\mu\text{m}$  的载板设备在客户端验证顺利。公司持续加大对 IC 载板新品的研发，今年 5 月公司推出 IC 载板解决方案新品 MAS 6P 系列、NEX 30 系列。MAS 6P 系列拥有业内领先的二次成像技术，可应用于高阶 HDI 和 IC 载板量产，NEX 30

系列作为阻焊 DI 性能标杆，为 ICS & SLP 载板阻焊首选；先进封装方面，公司自主研发的晶圆级封装设备 WLP2000 在再布线、互联、智能纠偏等方面都很有优势，以灵活的数字掩模和高良品率满足了半导体行业需求，此外，公司在 PLP 板级封装设备也有布局，支持在模组、光芯片、功率器件等领域的封装。报告期内，公司加快提升封装设备产能效率，以满足在更高算力的大面积芯片上的曝光环节适配有更高的产能效率和成品率；掩膜版制版方面，公司首台满足量产 90nm 制程节点的掩膜板制版设备已在客户端验证，今年公司将推进 90nm-65nm 制版光刻设备的研究进程，以满足掩膜版技术的更新迭代；新型显示方面，公司设备在解决 Mini/micro-LED 的芯片、基板制造及利用 RDL 再布线技术解决巨量转移问题均有较好的优势。公司将紧跟显示领域的市场需求发展趋势，为新型显示领域内的应用创造广阔空间；新能源光伏方面，公司将积极推动直写光刻技术在铜电镀图形化领域的产品开发及产业化验证力度，在 HJT/Topcon /XBC 等新型太阳能电池技术应用领域中不断发展。

### **3、推进前沿技术研发，打造新增长极**

作为技术创新驱动型公司，报告期内公司积极推进前沿技术研发，加快新品开发，紧握多重行业机遇。2024 年 4 月，公司推出了键合制程解决方案，成功研制新品 WA 8 晶圆对准机与 WB 8 晶圆键合机，此两款设备均为半导体加工过程中的关键设备。公司布局键合机，彰显研发实力强大，具备明显的先发优势。目前，公司在先进封装领域布局了直写光刻设备+晶圆对准机+晶圆键合设备，此外，也布局了先

进封装所需要的量测、曝光、检测的技术路线图，期待与半导体产业界客户进行更紧密的合作，在先进封装设备国产化的大势之下打造新增长极。

## **二、强化价值创造，提升股东回报**

公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化价值创造能力，努力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### **1、实施股份回购计划，坚决落实“提质增效重回报”行动**

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康可持续发展，2024年2月，公司实际控制人、董事长程卓女士提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，截至2024年7月，公司已实施完成本次股份回购，实际回购公司股份477,322股，占公司总股本131,419,086股的比例为0.3632%，支付的资金总额为人民币30,016,900.65元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份有利于形成上市公司和股东的“双赢”格局，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展。

### **2、持续实施现金分红，稳定投资者预期**

公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期稳定的投资回报。

2023年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公

公司以总股本 131,419,086 股扣除回购股份 477,322 股后的股份数量 130,941,764 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 104,753,411.20 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 58.42%，全体股东共享公司发展红利。同时，公司积极建立与实施一系列制度与措施，强化管理层与股东的利益共担共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长远发展。

### 三、推动数智化转型，全面提升运营管理水平

公司持续深化数智化变革，通过数据底座建设、管理信息系统等数智化工具，规范公司精益标准及业务流程，实现数据治理、业务赋能，全面提升公司整体运营管理水平。

报告期内，公司大力建设覆盖研发、制造、供应链、销售、客服、财务、人力资源等多个维度的信息化平台体系，借力数智化工具，建设一体化高效运营平台，优化业务流程，提升产品质量，降低成本，增强客户黏性和满意度，进一步践行以客户为中心的核心价值观。

在研发管理方面，公司加速 IPD 项目执行，推动全流程标准化落地，优化了技术开发、产品开发的方法、流程及制度，持续推进产品平台建设和矩阵式管理，保证新产品开发成功率，构筑技术、产品和解决方案的强有竞争力。同时公司进一步完善 PLM 研发管理信息化系统，加强研发管理，提升研发效率与业务协同能力；持续推进知识产权保护，加强核心技术专利的系统布局，为公司的可持续发展奠定基础。

在客户沟通与管理方面，积极建立健全 CRM 系统，通过市场获客、客户跟进、商机、销售、售后等流程的系统性可视化跟进，推进客户信息管理一体化建设，优化销售和服务流程，提高运营效率，深度挖掘客户价值，提升客户满意度和忠诚度，助力公司更高效地管理客户关系，提升销售业绩和运营效率；

在智能制造领域，公司以构建精益制造、智能制造为目标，加快推进供应链 SRM 系统和仓储 WMS 系统建设，优化仓库运营，提高存储和分发效率，通过开发一站式采购协同管理平台，搭建采购需求管理中心，为高效率、高质量、绿色、智能制造打下坚实基础。

#### **四、完善公司治理，推动公司高质量发展**

报告期内，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体如下：

##### **1、加快落实独立董事制度改革**

公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则等公司治理制度，深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

##### **2、完善内控建设**

为了更好的落实公司内部审计工作的开展，促进内部控制的建设推进，有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，

参照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》的相关规定，结合公司实际情况，特制定了《内部审计实施细则》，建立健全了公司内部审计制度，有助提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计监管力度，确保公司合规经营。

### **3、加强董监高相关培训**

公司董事、监事、高级管理人员积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作，公司未来亦将全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与相关培训。公司将持续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，自上而下强化合规建设，重视合规管理和内部监督，促进公司规范运作，切实推动公司高质量可持续发展。

### **五、加强募投项目管理，提升科技创新能力**

在募投项目的实施过程中，公司持续严格遵守相关法规指引及《公司募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，加速推进募投项目建设，以募投项目的落地巩固并提升公司行业竞争地位，拓宽公司业务覆盖的深度及广度，敏锐把握市场发展机遇，实现公司主营业务的可持续发展。

### **六、提高信息披露有效性，常态化投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平，增强市场透明度，树立良好企业形象。2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关

制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。2024年上半年，公司参加了2023年度科创板半导体设备专场业绩说明会，通过网络文字互动的形式，解读了公司2023年年度及2024年第一季度业绩信息，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，通过多元化渠道有效传递公司价值，公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台的问题，并将市场关注话题和投资者建议定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司质量提升。在投资者关系管理方面，公司积极组织投资者调研活动，与投资者面对面交流，在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任与支持。

## 七、关注“关键少数”，强化履职责任

报告期内，公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和中

小投资者利益的情况，在业务、人员、资产等方面与公司保持独立。公司通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督。公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

## 八、其他说明

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，不断优化行动方案并持续推进方案的落地，及时履行信息披露义务。公司也将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日